

性能特点：

- 频带：2-18GHz
- 插入损耗：6.3dB
- 开态驻波比：1.5
- 关态驻波比：1.5
- 输入 P1dB：28dBm
- 控制方式：0/-5V 控制
- 芯片尺寸：2.3mm×2.0mm×0.1mm

产品简介：

HH-SW0218A2 是一款 GaAs MMIC 开关矩阵芯片，其频率范围覆盖 2-18GHz，整个插入损耗小于 6.3dB，0/-5V 控制，主要应用于电子战、雷达等领域的开关网络组件。

电参数：（TA=25°C，）

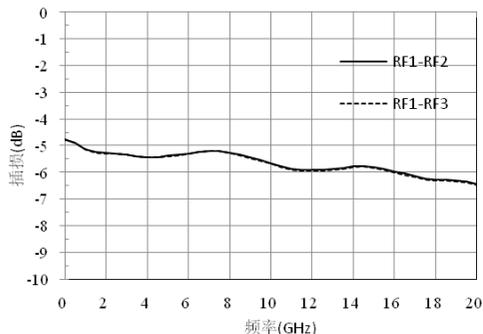
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2-18			GHz
插损	-	-	6.3	dB
开态驻波比	-	1.5	-	-
关态驻波比	-	1.5	-	dB
输入 P1dB	-	28	-	dBm

使用限制参数：

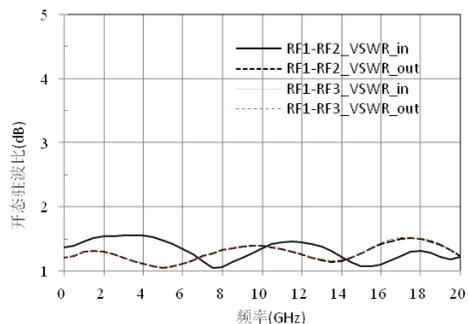
输入功率	30dBm
控制电压	-6V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

典型曲线：

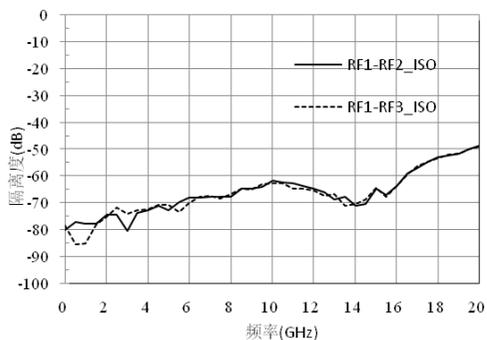
插入损耗



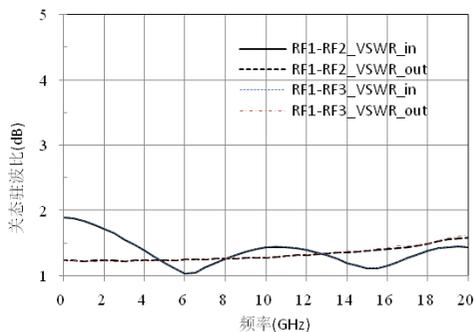
开态驻波比



隔离度



关态驻波比



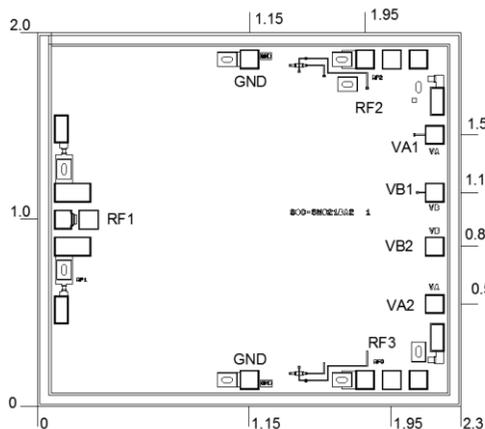
真值表：

VA1	VB1	RF1-RF2	VA2	VB2	RF1-RF3
0	-5	OFF	0	-5	OFF
-5	0	ON	-5	0	ON

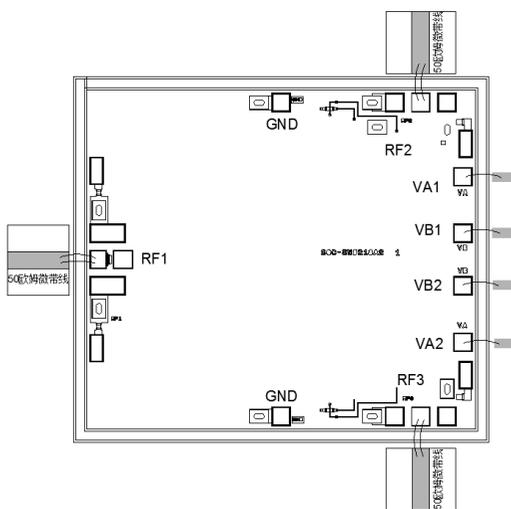
注：

- 1、芯片 VA1、VB1 和 VA2、VB2，分别控制各自边的开关通断。
- 2、两个开关可单独控制，互不干扰。

尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。